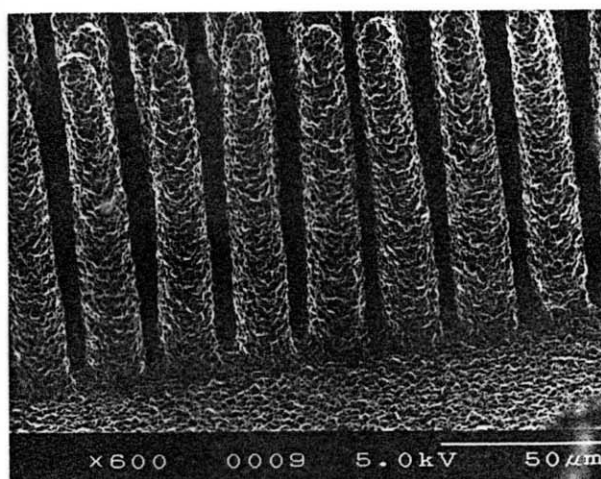
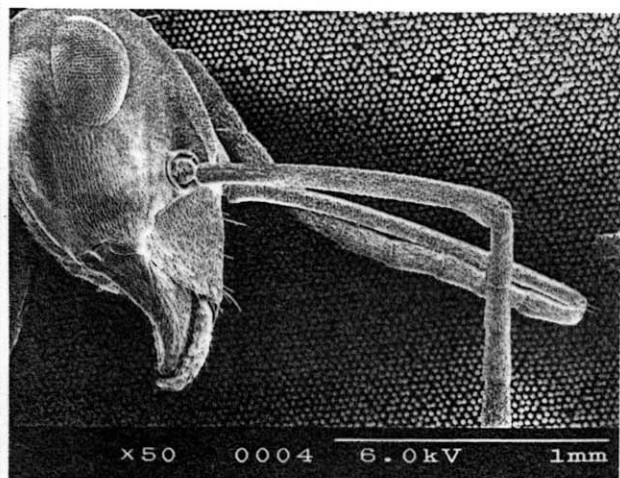


セラミックス微細加工技術



微細セラミックスアレイ
 <右は拡大写真>

(材料: PZT
 直径: $17\mu\text{m}$
 高さ: $120\mu\text{m}$)

■研究概要

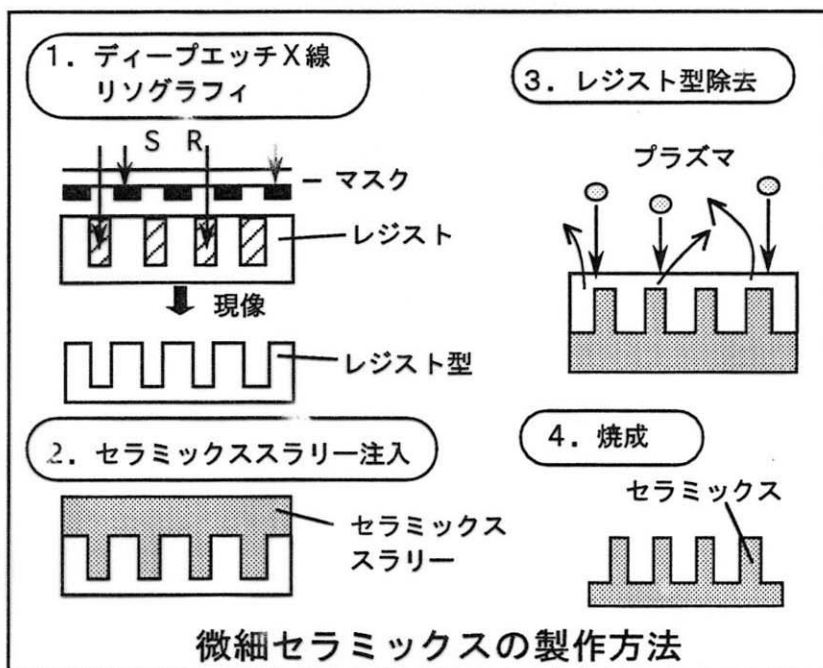
ディープエッチX線リソグラフィを用いたセラミックスの微細加工技術の開発に成功した。

■特徴・性能

1)右図プロセスで、レジスト型の除去にプラズマエッチングを採用

2)従来にない微細・高アスペクト比のセラミックス構造体の製作を実現

- ・寸法: $17\mu\text{m}$
- ・高さ: $120\mu\text{m}$
 (アスペクト比7)
- ・間隔: 最小 $3\mu\text{m}$



微細セラミックスの製作方法

住友電気工業 (株)

本研究は、工技院産技プロジェクトの一環として、NEDOから委託を受けた(財)マイクロマシンセンターの再委託業務として、住友電気工業(株)が実施したものである。